|  |
| --- |
| Муниципальный конкурс «Я выбираю» |
| Желаемая дата проведения компетенции | 21 ноября 14-16 лет |
| Место проведения | МАОУ «Лицей №97 г. Челябинска» филиал, Кирова 13-Б |
| Наименование компетенции | Инженерный дизайн CAD |
| Главный эксперт | Шутов Игорь Васильевич |
| Возраст  | 14-16 |

Конкурсное задание

|  |  |
| --- | --- |
| Формат и структура конкурсного задания | Конкурсное задание состоит из 1 модуля. Участникам предлагаются чертежи деталей, сборочных единиц, спецификации, а также текстовое описание задания |
| Продолжительность (лимит времени выполнения каждого модуля) | Конкурсное задание рассчитано на 4 часа. |
| Описание объекта (чертеж, схема, фото, изделие и др.) | Участнику предлагается к выполнению следующее задание:Пример детали: |
| Последовательность выполнения задания (возможно технологическая карта) | Изучив текстовое описание задания, чертежи и спецификации участник последовательно моделирует, в удобной для него САПР-системе, детали сборочные единицы, выполняет проектирование чертежей, фотореалистичных изображений и анимаций согласно заданию. |
| Критерии оценки(параметр и количество баллов) | Моделирование деталей: 20 балловМоделирование сборки: 10 балловЧертежи согласно заданию: 10 балловФотореалистичное изображение: 5 балловАнимация согласно заданию: 5 балловИтого: 50 баллов |
| Требования От и ТБ. | Подготовить рабочее место: убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднятьработу; проверить правильность установки стола, стула и, при необходимости, провестирегулировку; отрегулировать освещенность, убедиться в достаточной освещенности, отсутствииотражений на экране, отсутствии встречного светового потока;Запрещается:касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании;переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройствпри включенном питании;производить отключение питания во время выполнения активной задачи;производить частые переключения питания;допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора,рабочую поверхность клавиатуры, дисковода, принтера и др. устройств;производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; |